

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他(电话会议) <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	信达澳亚基金管理有限公司（冯明远），中国国际金融股份有限公司（贾顺鹤），中信建投证券股份有限公司（周新建、邹鑫）等（排名不分先后）
时间	2023年11月24日（星期五）下午14:00至16:00
地点	劲拓光电产业园会议室、部分生产车间
上市公司接待人员姓名	董事长 王新杰先生 副总经理、董事会秘书 陈文娟女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、接待人员介绍公司基本情况</p> <p>（一）公司简介</p> <p>劲拓股份（300400）是一家深圳证券交易所创业板上市公司，成立于2004年，2014年登陆创业板。公司有两个自建工业园，目前同步使用中，建筑面积合计约10万平方米，本次活动所在位置是宝安石岩的劲拓光电产业园。</p> <p>（二）公司从事的主要业务</p> <p>公司主营专用设备业务，具体可分为三类：电子装联设备（电子热工设备及配套设备）、半导体专用设备、光电显示设备。</p> <p>1、公司设立以来持续深耕电子热工领域，被行业协会授予“电子热工领域龙头企业”称号，回流焊设备获国家工信部“制造业单项冠军产品”认证、全球市场占有率领先。此项业务系公司领先优势业务，也是公司的基本盘。</p> <p>2、公司2022年起规模化销售半导体专用设备，目前系公司集中资源发展的战略级业务。半导体专用设备实现关键技术突破，研制生产了半导体芯片封装炉、Wafer Bumping 焊接设备、真空甲酸焊接设备、甩胶机、氮气烤箱、无尘压力烤箱等多款半导体热工设备、硅片制造设备，并具备为客户提供不同制造工艺设备的定制能力；产品累计交付服务客户超过20家，获得客户的认可、验收及复购。</p> <p>3、公司主营产品还包含光电显示设备，应用领域覆盖 AMOLED 柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载屏、可穿戴类屏体、光电模组、半导体复合铜片</p>

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>等的制程，产品突破海外技术封锁，得到京东方等国产面板厂商和大型模组厂的认可并实现长期深度合作。</p> <p>（三）公司的经营情况</p> <p>2023 年前三季度，公司实现营业总收入 55,679.04 万元，较上年同期增长 0.41%；归属于上市公司股东的净利润 3,856.91 万元，经营活动产生的现金流量净额 6,328.84 万元。公司 2023 年前三季度具体经营情况，可参见披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》《2023 年三季度报告》。</p> <p>二、问答交流</p> <p>1、公司半导体专用设备有哪些？应用领域有哪些？</p> <p>回复：公司半导体专用设备目前以应用于芯片制程后道工艺的封装热处理设备为主，包含半导体芯片封装炉、Wafer Bumping 焊接设备、真空甲酸焊接设备、甩胶机、氮气烤箱、无尘压力烤箱等，广泛应用于各类芯片元器件的封装过程及先进封装工艺，产品具体情况可以参见公司《2023 年半年度报告》。公司半导体专用设备目前主要面向国内封测厂商，累计服务客户逾 20 家，其中包含优质的上市公司、大型企业。</p> <p>公司未来将持续推动产品在 IGBT、IC 载板、WaferBumping、ClipBonding、FCBGA 等生产制造领域应用，扩大客户群体、促进收入规模增长。</p> <p>2、电子装联设备下游应用领域有哪些？市场前景展望如何？</p> <p>回复：公司电子装联设备用于组建电子工业中的 PCBA 生产线，应用范围较为广泛，不仅包含通讯电子和消费电子，还有白色家电、汽车电子、航空航天电子等领域。消费电子行业需求回暖、固定资产投资复苏，对公司电子装联业务的市场拓展和产品销售有积极影响。</p> <p>3、公司光电显示设备主要有哪些产品？应用领域有哪些？</p> <p>回复：公司光电显示设备用于光电平板（TP/LCD/OLED）显示模组的生产制造过程，按功能分类主要有 3D 贴合设备、生物识别模组生产设备、LCM 焊接类设备、贴附机等，相关产品已经覆盖 AMOLED 柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载屏、可穿戴类屏体、光电模组、半导体复合铜片贴合等多种应用领域。</p> <p>4、公司 AOI 检测设备用途是什么？</p> <p>回复：AOI 为自动光学检测，AOI 检测设备是基于光学原理利用机器视觉对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备，是电子产品生产线配</p>
----------------------	--

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>置的主要品质检测设备之一。公司检测设备主要与电子热工设备共同组建 SMT 生产线，用于满足部分客户的一站式采购需要，目前收入占比不大。</p> <p>5、电子装联业务 2024 年业绩预期如何？</p> <p>回复：广泛的消费电子行业除智能手机、PC 等，还包含汽车电子、智能家居等领域，近年来以智能手机为主的消费电子行业经历了一轮下行周期后，逐渐呈现企稳态势；而汽车电子等领域受到新能源汽车市场需求旺盛等因素影响，市场景气度相对好；泛消费电子行业呈现结构性行情，而大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能、5G 通信等新技术的应用，对于新型硬件需求产生刺激作用。行业需求回暖、固定资产投资复苏，预计长期将对公司电子装联业务的市场拓展和产品销售有积极影响。</p> <p>公司电子热工设备产品和技术成熟度较高，处于行业领先地位。随着有关应用领域对工艺和技术要求升级，设备向智能化、灵活化、环保化，以及更高精度、高速度、多功能方向发展，还需要具备非标准化设备服务能力。公司将继续通过研发创新、产品升级筑牢业务发展根基、深挖护城河，不断推动电子整机装联业务持续高质量发展。</p> <p>6、公司今年前三季度研发费用增长，后续的研发计划是什么？</p> <p>回复：公司后续将继续攻关芯片封测等环节一些有技术壁垒且国产空白的半导体专用设备，推动半导体专用设备产品拓展、性能提升、研发成果转化；同时汲取不同场景的应用经验，优化和提升电子装联设备、光电显示设备性能，提高产品技术壁垒。</p> <p>7、能否分别分析今年前三季度业绩的具体情况，以及明年的总体预期情况？</p> <p>回复：公司 2023 年三季度主要受到市场环境等因素影响，短期收入承压、业绩波动；同时由于研发投入和营销力度加大等原因，致使相关费用增加，对净利润有所影响。</p> <p>公司当前主营业务经营情况稳健，未来将继续立足于电子装联业务基本盘，梳理和整合内外部资源、推动战略级业务半导体专用设备业务发展，力争把握产业趋势和结构性机会扩大收入规模、增厚业绩；同时继续落实资源利用、降本增效、精益生产和供应链管理系列措施，开源节流、提升盈利水平。公司各期经营业绩具体情况，敬请以公司披露于巨潮资讯网的定期报告、相关临时公告为准。</p> <p>8、公司控股股东、实际控制人吴限先生拟委托公司表决权事项进展情</p>
----------------------	---

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>况如何？吴限先生目前是否在公司任职？</p> <p>回复：（1）公司控股股东、实际控制人吴限先生筹划向东阳经鸿伟畅企业管理合伙企业（有限合伙）委托其所持公司 27.9%表决权，该事项可能导致公司控制权变更。吴限先生拟委托其表决权事项目前处于意向阶段，公司于 2023 年 1 月 30 日披露了双方《表决权委托意向协议》有关内容，同时结合双方后续签署的补充协议，该《表决权委托意向协议》有效期至以下三个时点中较早之日止：①委托方、受托方签署《表决权委托协议》且协议生效之日；②委托方、受托方签署《表决权委托意向协议之终止协议》且协议生效之日；③2023 年 12 月 31 日。</p> <p>根据双方提供的书面文件：截至公司《2023 年三季度报告》报告日，双方正就《表决权委托意向协议》项下表决权委托事项方案进行深入论证和详细磋商，后续是否签署正式协议并实施、实施计划等均存在不确定性。</p> <p>本次控股股东拟筹划的公司控制权变更相关事项尚存在不确定性。针对该事项进展情况，公司将在获知有关进展后及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告，谨慎决策、注意投资风险。</p> <p>（2）吴限先生是公司的创始人，目前在公司任职，不担任公司治理层、高级管理职务。</p> <p>三、现场参观</p> <p>调研过程中，调研人员有序参观了公司部分电子装联设备、半导体专用设备及光电显示设备生产车间。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 11 月 24 日</p>